

# Capitolo 1

## Estrazione dei parametri statici

### 1.1 Tensione di soglia

La tensione di soglia  $V_{th}$  di un transistor MOS è definita come quella tensione tra gate e bulk per la quale la popolazione di minoritari all'interfaccia è uguale alla popolazione di maggioritari nel bulk. Questa definizione non può essere usata direttamente per il calcolo della tensione di soglia dei dispositivi, ma si deve passare attraverso l'analisi delle caratteristiche corrente-tensione dei dispositivi.

Per l'estrazione del parametro  $V_{th}$  esistono numerosi metodi, ognuno con punti di forza e punti di debolezza diversi. La scelta di quale metodo utilizzare non è banale e per farla occorre analizzare le caratteristiche di ciascun metodo e confrontare i risultati che offrono. Per questo studio sono stati presi in considerazione:

- *Transconductance Change Method (TCM)*;
- *Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method (SDLM)*;
- *Extrapolation in the Linear Region method (ELR)*.

#### 1.1.1 Transconductance Change Method

Il *Transconductance Change Method*, *TCM*, definisce la tensione di soglia come la tensione di gate  $V_{GS}$  corrispondente al picco massimo della derivata della transconduttanza  $g_m$  rispetto alla tensione di gate ( $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$ ) ed è valido

per bassi valori della tensione  $V_{DS}$ .

Questa definizione si basa sul fatto che, quando il dispositivo passa dalla regione di debole inversione alla regione di forte inversione, la dipendenza della corrente di drain rispetto a  $V_{GS}$  passa dall'essere esponenziale all'essere quasi costante. La transconduttanza è definita come la derivata prima della corrente  $I_D$  rispetto alla tensione  $V_{GS}$ , dunque la derivata della  $g_m$  corrisponde alla derivata seconda di  $I_D$ . Per questo motivo, il massimo di  $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$  coincide con la tensione alla quale il grafico della corrente passa dalla forma esponenziale a quella quasi costante, ovvero la tensione  $V_{GS} + V_{DS}$ . Se  $V_{DS}$  è piccola, la tensione per la quale la  $g_m$  è massima è molto simile a  $V_{th}$ .

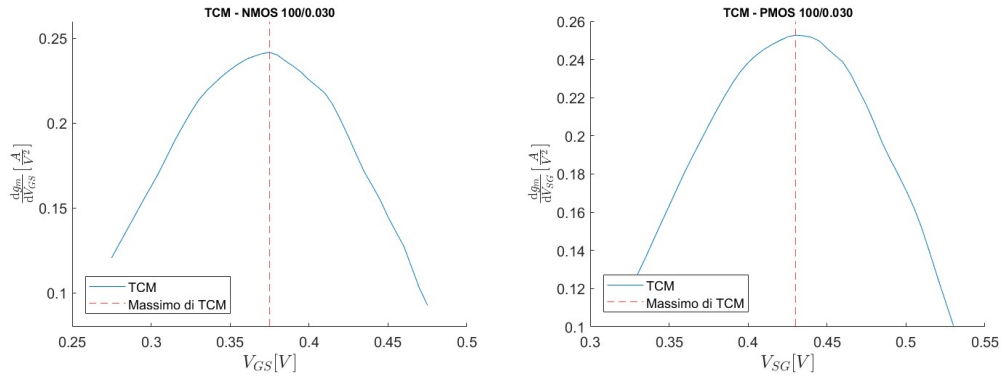


Figura 1.1: Esempio di *TCM* usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-30 a  $V_{DS} = 150mV$

*TCM*, poiché si basa sul massimo di una funzione, è molto sensibile ai picchi dovuti ad errori di misura e perciò non è molto affidabile: è quindi necessario rendere la funzione studiata meno dipendente dai campionamenti fuori scala. Inoltre, la risoluzione del dispositivo di misura utilizzato è di  $5mV$ , il che rende i valori ottenuti della  $V_{th}$  molto approssimativi. Per far fronte a questi due problemi, si è scelto di non tenere conto del massimo direttamente ottenuto dallo studio di  $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$  ottenuto dai valori delle misure, ma di interpolare prima i punti del grafico con una funzione polinomiale e, solo a questo punto, di prendere in considerazione il picco di massimo.

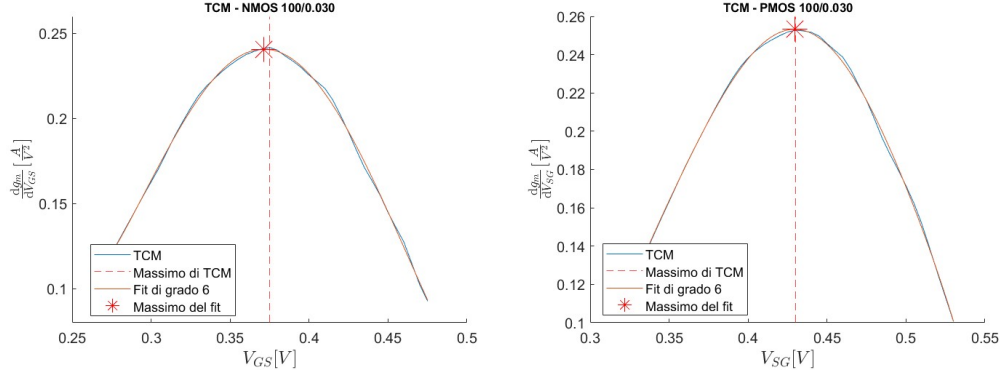


Figura 1.2: Esempio di *TCM* con fit polinomiale usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-30 a  $V_{DS} = 150mV$

Lo studio del fit polinomiale risolve il problema della bassa risoluzione di misura e il problema della presenza di valori fuori scala, ma presenta una potenziale nuovo problema: il valore della  $V_{th}$  calcolata potrebbe variare significativamente al variare del grado della funzione polinomiale interpolante. Questa differenza non è molto alta, si parla di pochi millivolt, perciò non influenza considerevolmente il valore della singola estrazione. Questa dipendenza, però, è problematica nel momento in cui si vuole studiare con precisione la degradazione delle prestazioni di un dispositivo all'aumentare dell'irraggiamento subito, in quanto piccoli spostamenti del valore di  $V_{th}$  dovuti alla scelta arbitraria del grado della polinomiale può far variare eccessivamente le differenze delle misure tra un irraggiamento e l'altro, elemento inaccettabile se si considera che già le misure sono influenzate da errori casuali in fase di misura.

Prendendo come esempio i dispositivi PMOS, si è studiato quanto cambia il valore della tensione di soglia al variare del grado del fit polinomiale, prendendo in considerazione i gradi di valore 2, 4, 6 e 8.

Osservando i valori nella tabella 1.1, si può notare che la tensione di soglia ottenuta non varia molto nel caso dei fit fatti con polinomiali di grado 4, 6 e 8: è raro che la differenza tra questi valori superi  $1mV$ . Non si può dire la stessa cosa per le  $V_{th}$  calcolate con fit di grado 2: in questo caso la funzione interpolante ha un grado troppo basso per seguire in modo coerente la curva  $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$  e quindi il massimo risulta essere sia molto diverso da quelli calcolati con fit di grado maggiore, sia da quello di ottenuto senza fit. Dunque di

Dispositivo	$V_{th}[mV]$ con grado:			
	2	4	6	8
100 - 30	426.9	429.4	429.4	430.8
100 - 60	467.6	469.5	469.3	468.9
200 - 30	397.8	399.7	399.3	399.8
200 - 60	452.2	454.1	453.5	453.5
200 - 180	495.6	495.6	495.3	495.5
600 - 30	383.0	387.4	385.9	386.2
600 - 60	431.1	434.3	434.7	435.6
600 - 180	478.5	480.8	480.6	480.0

Tabella 1.1: Confronto dei valori di  $V_{th}$  dei dispositivi PMOS ottenuti con *TCM* con fit polinomiale di diversi gradi

sicuro usare un fit di grado 2 porta a risultati scorretti, mentre usare un fit di grado superiore dovrebbe portare a risultati sicuramente accettabili. Per il confronto con altri metodi per l'estrazione della  $V_{th}$  si terrà quindi conto del TCM con fit polinomiale di grado 6, tabelle 1.2 e 1.3.

Dispositivo	$V_{th}[mV]$						
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 30	429.4	430.7	432.2	434.4	439.0	452.6	459.4
100 - 60	469.3	469.6	471.4	472.7	479.7	491.8	500.8
200 - 30	399.3	401.0	403.1	404.8	410.2	422.3	429.8
200 - 60	453.5	455.2	456.2	458.6	463.8	476.9	485.8
200 - 180	495.3	497.1	503.9	506.5	511.3	524.1	535.3
600 - 30	385.9	386.6	388.8	391.0	394.5	405.5	412.3
600 - 60	434.7	435.4	438.5	438.9	445.6	458.4	467.8
600 - 180	480.6	481.5	483.7	486.0	492.0	507.2	519.6

Tabella 1.2:  $V_{th}$  dei dispositivi PMOS estratte con *TCM*

Dispositivo	$V_{th}[mV]$				
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad
100 - 30	371.3	370.6	361.0	380.6	378.7
100 - 60	405.0	399.9	390.0	419.8	418.8
100 - 180	476.0	472.4	459.5	491.9	491.2
200 - 30	359.5	357.9	348.1	369.2	367.0
200 - 60	402.2	398.3	385.0	415.5	413.7
200 - 180	466.4	463.5	451.8	484.6	483.8
600 - 60	370.2	364.4	359.3	379.5	381.0
600 - 180	449.6	447.9	430.7	458.8	458.4

Tabella 1.3:  $V_{th}$  dei dispositivi NMOS estratte con *TCM*

### 1.1.2 Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method

Il secondo metodo analizzato è il *Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method*, *SDLM*. Questo metodo definisce la  $V_{th}$  come la tensione  $V_{GS}$  per la quale si ha il picco minimo della derivata seconda del logaritmo naturale di  $I_D$  ripetuto alla tensione di gate ( $\frac{d^2 \ln I_D}{dV_{GS}^2}$ ) e vale solo per alti valori di  $V_{DS}$ .

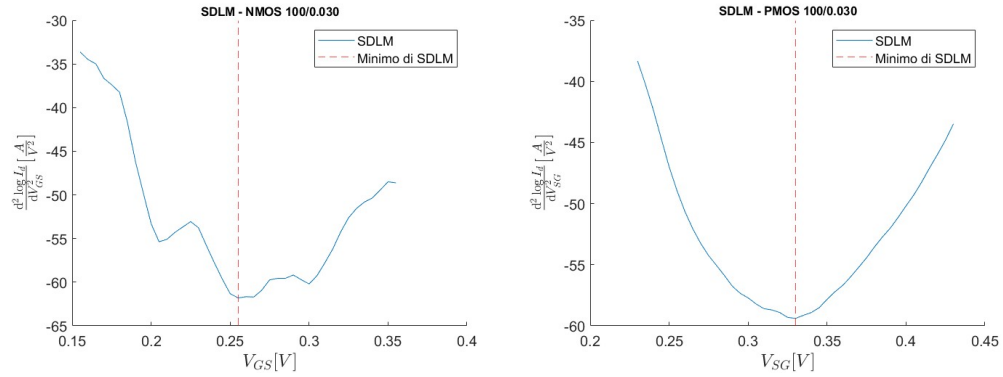


Figura 1.3: Esempio di *SDLM* usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-30 a  $V_{DS} = 900mV$

Anche per questo metodo si ritrovano le problematiche presenti per il *TCM*: il valore minimo della funzione analizzata è fortemente influenzata dai valori fuori scala e la risoluzione dello strumento di misura è di  $5mV$  e dunque troppo grossolana per ottenere un valore preciso di  $V_{th}$ . Quindi, anche per questo metodo, abbiamo deciso di interpolare la funzione ottenuta con una polinomiale e considerare il minimo di quest'ultima.

Prendendo in considerazione i dati presenti nella tabella 1.1, si nota come  $V_{th}$  assume valori molto diversi a seconda del grado della polinomiale interpolante. Nella maggior parte dei casi, le tensioni di soglia ottenute con polinomiali di grado basso (2 e 4) cambiano molto tra loro e rispetto a quelle ottenute con polinomiali di grado alto (6 e 8), mentre le misure ottenute con queste ultime sono, in genere, molto simili tra loro. Osservando i grafici relativi alla *SDLM* del PMOS 200-30 (figura ??), si può notare che il plot della

Tabella 1.4: Confronto dei valori di  $V_{th}$  dei dispositivi PMOS ottenuti con *SDLM* con fit polinomiale di diversi gradi

Dispositivo	$V_{th}$ con fit di grado 2 [mV]	$V_{th}$ con fit di grado 4 [mV]	$V_{th}$ con fit di grado 6 [mV]	$V_{th}$ con fit di grado 8 [mV]
100 - 30	332.0	322.3	323.5	327.2
100 - 60	423.1	416.1	411.6	411.7
200 - 30	303.2	298.8	296.5	296.7
200 - 60	413.1	404.4	404.9	405.0
600 - 180	454.7	446.7	441.4	441.3
600 - 30	296.0	291.4	289.7	298.1
600 - 60	398.3	393.3	391.8	389.6
200 - 180	460.4	453.5	449.3	448.7

funzione  $\frac{d^2 \ln I_D}{dV_{GS}^2}$  ha un andamento che non viene interpolato in modo preciso da polinomiali di basso grado: per questo i valori minimi si discostano parecchio dai minimi ottenuti con polinomiali di grado maggiore. Risulta, infatti, che *SDLM* è più sensibile agli errori di misurazioni rispetto a *TCM* e quindi i grafici sono meno approssimabili a polinomiali di baso grado. Si ha dunque che:

- i fit di grado basso non interpolano in modo preciso il grafico di  $\frac{d^2 \ln I_D}{dV_{GS}^2}$  i valori minimi variano considerevolmente al variere del grado.
- i fit di grado alto interpolano bene il grafico di partenza e i valori minimi sono simili tra loro, ma influenzati dagli errori di misura

Non è quindi semplice capire quale grado usare per interpolare  $\frac{d^2 \ln I_D}{dV_{GS}^2}$  e, in generale, abbiamo concluso che questo metodo non pare molto affidabile per questo studio. In ogni caso, per i futuri confronti tra i metodi si terrà lo stesso in conti l'*SDLM*, usando un fit di grado 6, che può essere considerata un'accettabile via di mezzo tra le polinomiali che non interpolano bene il grafico di partenza e quelle che sono troppo influenzate dagli errori di misura.

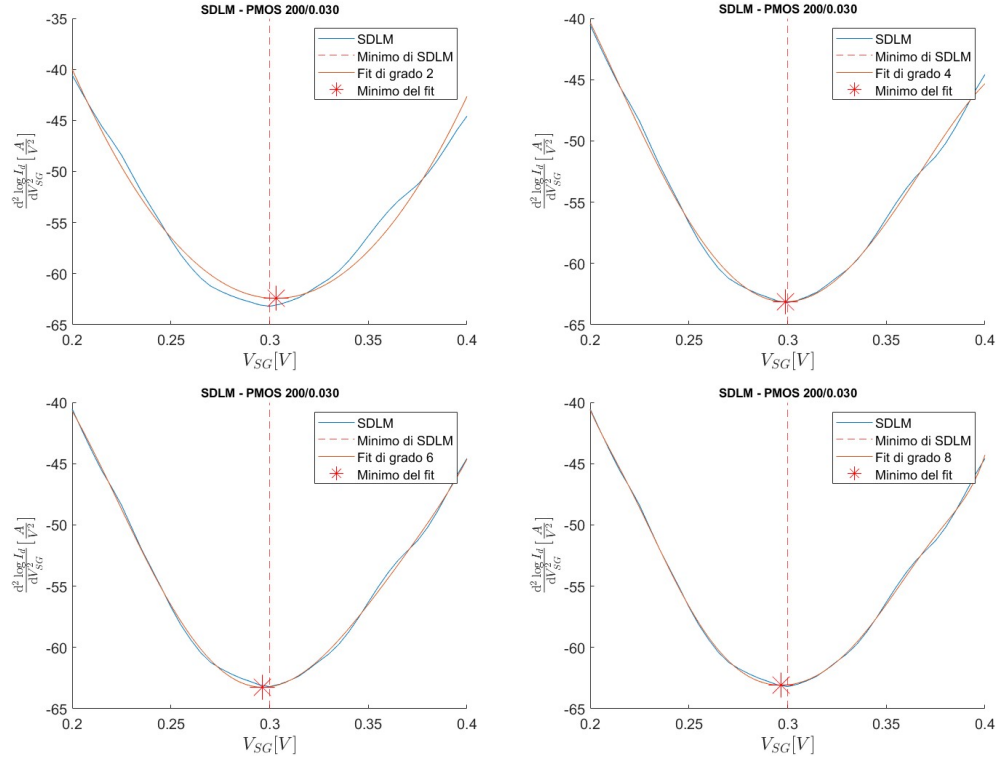


Figura 1.4: Confronto dei valori di  $V_{th}$  del dispositivo PMOS 200-30 ottenuti con *SDLM* con fit polinomiale di diversi gradi

Dispositivo	$V_{th}[mV]$						
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 30	323.5	329.9	327.3	330.7	329.7	343.2	355.8
100 - 60	411.6	409.9	412.3	415.5	416.8	428.3	435.8
200 - 30	296.5	292.4	301.7	299.8	304.4	320.0	323.0
200 - 60	404.9	403.9	405.3	407.3	413.0	422.5	430.9
200 - 180	449.3	452.1	457.6	456.9	461.9	473.7	482.7
600 - 30	289.7	293.0	297.3	297.0	299.9	313.1	325.7
600 - 60	391.8	393.4	397.4	396.8	402.0	415.1	421.2
600 - 180	441.4	443.4	445.1	444.6	450.9	464.5	474.2

Tabella 1.5:  $V_{th}$  dei dispositivi PMOS estratte con *SDLM*



Dispositivo	$V_{th}[mV]$					
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad 1Grad
100 - 30	287.7	259.5	271.2	289.8	287.7	
100 - 60	356.8	327.2	322.7	360.9	356.8	
100 - 180	404.8	381.5	369.1	422.1	404.8	
200 - 30	279.7	262.2	269.6	277.9	279.7	
200 - 60	355.3	325.4	313.3	357.4	355.3	
200 - 180	417.9	378.9	372.5	418.8	417.9	
600 - 60	334.4	276.0	304.0	336.1	334.4	
600 - 180	417.1	381.5	379.6	418.4	417.1	

Tabella 1.6:  $V_{th}$  dei dispositivi NMOS estratte con *SDLM*

### 1.1.3 Extrapolation in the Linear Region method

Il terzo metodo analizzato è l'*Extrapolation in the Linear Region method*, *ELR*, con il quale si ottiene la misura della  $V_{th}$  attraverso l'analisi della caratteristica  $I_D - V_{GS}$ . Tale grafico presenta un punto di flesso attorno al quale il grafico è linearizzabile. Il valore di  $V_{th}$  si ottiene sommando la metà del valore di  $V_{DS}$  al valore di  $V_{GS}$  al quale il fit lineare, ottenuto nell'intorno del punto di flesso, interseca l'asse delle ascisse.

Di per sé, questo metodo è meno preciso di quelli esposti precedentemente: la posizione del punto di flesso può essere incerto, perché, già a  $V_{GS}$  leggermente superiori a  $V_{th}$ , la caratteristica  $I_D - V_{GS}$  può deviare dall'andamento lineare previsto a causa di errori dovuti alle resistenze parassite presenti al source e al drain dei dispositivi. Nonostante ciò, per il nostro studio questo metodo potrebbe risultare efficace, in quanto non siamo interessati al valore della tensione di soglia dei dispositivi, ma alla differenza di tale parametro all'aumentare dell'irraggiamento subito dai dispositivi. Dunque l'errore prodotto dalle resistenze parassite divenuta irrilevante, perché è un offset che viene eliminato nel momento in cui si calcola la differenza tra due misure di  $V_{th}$  dello stesso dispositivo.

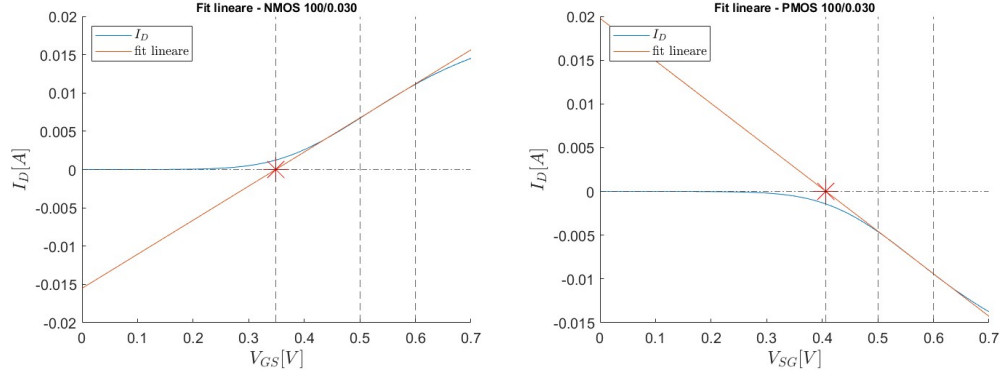


Figura 1.5: Fit lineare della caratteristica  $I_D$ - $V_{GS}$  a  $V_{DS} = 150mV$  di un NMOS e di un PMOS di dimensioni 100-30 nell'intorno  $[0, 5V; 0, 6V]$  di  $V_{GS}$

Dispositivo	$V_{th}[mV]$						
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad	1Grad
100 - 30	405.8	406.6	408.6	410.1	416.1	429.3	436.6
100 - 60	452.0	452.9	454.6	456.5	462.9	475.4	484.9
200 - 30	376.2	377.6	379.3	380.3	386.9	397.5	404.7
200 - 60	434.6	435.9	437.5	439.3	445.1	458.1	467.2
200 - 180	482.3	483.5	490.3	492.4	498.5	511.5	522.6
600 - 30	359.4	360.9	362.5	364.6	370.1	379.8	387.1
600 - 60	412.8	414.2	417.1	417.5	424.5	437.3	446.1
600 - 180	463.2	464.4	466.4	468.9	475.2	490.8	502.9

Tabella 1.7:  $V_{th}$  dei dispositivi PMOS estratte con *ELR*

Dispositivo	$V_{th}[mV]$					
	pre	5Mrad	50Mrad	100Mrad	200Mrad	600Mrad 1Grad
100 - 30	351.0	348.5	338.8	360.4	440.1	
100 - 60	388.8	385.3	373.1	403.8	361.4	
100 - 180	465.9	461.6	449.4	482.5	471.0	
200 - 30	336.9	334.6	324.6	346.0	395.1	
200 - 60	382.9	379.4	366.4	396.6	344.7	
200 - 180	454.6	449.8	438.1	471.1	481.7	
600 - 60	349.3	347.2	336.7	361.2	402.0	
600 - 180	431.8	427.5	412.4	440.6	358.4	

Tabella 1.8:  $V_{th}$  dei dispositivi NMOS estratte con *ELR*